



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月26日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月6日 配当支払開始予定日 平成27年11月27日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	57,143	5.9	788	37.5	647	46.4	416	44.8
27年3月期第2四半期	53,952	14.3	573	22.4	442	90.2	287	34.4

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 409百万円(186.3%) 27年3月期第2四半期 143百万円(△56.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第2四半期	41.73	—
27年3月期第2四半期	28.89	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第2四半期	60,956	22,913	37.6
27年3月期	69,449	22,777	32.8

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 22,911百万円 27年3月期 22,777百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	30.00	—	30.00	60.00
28年3月期	—	30.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	30.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	117,000	4.8	1,600	17.8	1,050	46.4	105.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

28年3月期2Q	10,445,500株	27年3月期	10,445,500株
28年3月期2Q	449,884株	27年3月期	474,800株
28年3月期2Q	9,986,161株	27年3月期2Q	9,964,000株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び従業員持株ESOP信託を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報)	9
4. 補足情報	10
(1) 仕入、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資の持ち直しがみられるものの、中国経済の成長が鈍化していることなどを背景に景気の回復は足踏み状態となっております。また、グローバルでも景気後退懸念が強まり、先行きの不透明感が払拭できない状況となっております。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の業績については、売上高571億4千3百万円（前年同期比5.9%増）、売上高の増加等に伴い、営業利益7億8千8百万円（前年同期比37.5%増）、経常利益6億4千7百万円（前年同期比46.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益4億1千6百万円（前年同期比44.8%増）となりました。

報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

半導体メーカーの再編が進む中、自動車に搭載される電子デバイスの増加やIoT社会の到来等により半導体の需要拡大が見込まれておりますが、中国では産業機器の一部やスマートフォン関連の設備投資に陰りがみられるなど、警戒感が生じております。

このような状況のもと、販売代理店契約解消に伴う売上高の減少があったものの、PC関連製品やPOS端末向けなどの半導体の販売が総じて堅調に推移したほか、車載向けにアナログICをはじめとする半導体の販売に注力した結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は486億9千8百万円（前年同期比3.7%増）、セグメント利益（経常利益）は3億7千5百万円（前年同期比20.1%増）となりました。

(コンピュータシステム関連事業)

企業収益の改善等により、凍結されていたシステム案件が一部で再開される中、「マイナンバー制度」への対応に向けた準備等に伴う需要も出始めております。

このような状況のもと、機器販売が官公庁向けのほか金融機関やデータセンター向けに堅調な推移となったことなどから、当第2四半期連結累計期間における売上高は84億4千4百万円（前年同期比21.1%増）、売上高の増加等により、セグメント利益（経常利益）は2億7千2百万円（前年同期比109.5%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は609億5千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ84億9千3百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品が減少したことによります。負債総額は380億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ86億2千9百万円の減少となりました。これは主に、買掛金及び短期借入金が増加したことによります。また、純資産総額は229億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3千5百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は37.6%となり前連結会計年度末に比べ4.8ポイント向上いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

「(1)経営成績に関する説明」に記載のとおり、当第2四半期連結累計期間の業績は予想を上回る結果となりました。通期の業績見通しについては、売上高が引き続き堅調に推移する一方、当初は見込まれていなかった利益率の低いビジネスの売上構成比に占める割合が拡大する見通しとなることから、利益については据え置くこととし、平成28年3月期通期連結業績予想を次のとおり修正いたします。

	売上高	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
前回（平成27年4月24日） 発表予想（A）	百万円 114,000	百万円 1,600	百万円 1,050	円 銭 105.31
今回発表予想（B）	117,000	1,600	1,050	105.31
増 減 額（B－A）	3,000	—	—	—
増 減 率（％）	2.6	—	—	—
（参考）前期連結実績 （平成27年3月期）	111,664	1,358	717	71.99

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(参考)

当第2四半期連結会計期間より、TOKYO ELECTRON DEVICE (THAILAND) LIMITEDを設立し、新たに連結の範囲に含めております。なお、特定子会社ではありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,302	1,342
受取手形及び売掛金	28,160	26,172
電子記録債権	700	543
商品及び製品	24,981	22,385
仕掛品	36	24
その他	7,434	4,910
流動資産合計	63,615	55,379
固定資産		
有形固定資産	902	854
無形固定資産	1,099	950
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	964	989
その他	2,877	2,793
貸倒引当金	△10	△11
投資その他の資産合計	3,831	3,771
固定資産合計	5,833	5,577
資産合計	69,449	60,956
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,673	7,633
短期借入金	16,418	10,371
1年内返済予定の長期借入金	96	2,096
賞与引当金	738	665
その他	6,872	6,585
流動負債合計	33,799	27,352
固定負債		
長期借入金	5,384	3,336
退職給付に係る負債	6,768	6,800
その他	720	553
固定負債合計	12,872	10,690
負債合計	46,671	38,042

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	14,618	14,722
自己株式	△703	△666
株主資本合計	22,056	22,196
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5	-
繰延ヘッジ損益	△36	48
為替換算調整勘定	366	349
退職給付に係る調整累計額	386	316
その他の包括利益累計額合計	721	714
非支配株主持分	-	2
純資産合計	22,777	22,913
負債純資産合計	69,449	60,956

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)
売上高	53,952	57,143
売上原価	46,606	49,537
売上総利益	7,346	7,605
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	2,924	2,884
賞与引当金繰入額	404	651
退職給付費用	373	259
その他	3,071	3,020
販売費及び一般管理費合計	6,773	6,816
営業利益	573	788
営業外収益		
受取保険金	-	22
保険配当金	35	37
その他	6	13
営業外収益合計	42	74
営業外費用		
為替差損	110	144
その他	62	71
営業外費用合計	173	215
経常利益	442	647
特別利益		
関係会社出資金売却益	-	8
特別利益合計	-	8
特別損失		
固定資産除却損	2	3
投資有価証券売却損	-	9
その他	0	1
特別損失合計	2	14
税金等調整前四半期純利益	439	641
法人税等	151	224
四半期純利益	287	416
親会社株主に帰属する四半期純利益	287	416

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益	287	416
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	△5
繰延ヘッジ損益	△187	84
為替換算調整勘定	91	△6
退職給付に係る調整額	△58	△70
持分法適用会社に対する持分相当額	7	△9
その他の包括利益合計	△144	△7
四半期包括利益	143	409
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	143	409
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	439	641
減価償却費	245	241
のれん償却額	51	51
賞与引当金の増減額(△は減少)	37	△73
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	150	15
支払利息	28	34
投資有価証券売却損益(△は益)	-	9
関係会社出資金売却損益(△は益)	-	△8
売上債権の増減額(△は増加)	△3,736	2,107
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,331	2,587
仕入債務の増減額(△は減少)	△242	△2,028
未払金の増減額(△は減少)	182	△732
前受金の増減額(△は減少)	711	1,053
未収消費税等の増減額(△は増加)	219	2,694
未収入金の増減額(△は増加)	537	251
前払費用の増減額(△は増加)	△462	△354
その他	425	△461
小計	△2,743	6,027
利息及び配当金の受取額	5	0
利息の支払額	△28	△36
法人税等の支払額	△218	△571
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,985	5,421
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△28	△39
無形固定資産の取得による支出	△104	△74
投資有価証券の売却による収入	-	43
関係会社出資金の売却による収入	-	20
その他	4	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,078	△6,033
長期借入れによる収入	3,000	-
長期借入金の返済による支出	-	△48
自己株式の取得による支出	△859	-
自己株式の処分による収入	-	39
配当金の支払額	△318	△299
その他	△1	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,898	△6,339
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△192	△959
現金及び現金同等物の期首残高	1,285	2,302
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	14	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,108	1,342

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	46,978	6,973	53,952	—	53,952
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	46,978	6,973	53,952	—	53,952
セグメント利益	312	129	442	—	442

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	48,698	8,444	57,143	—	57,143
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	48,698	8,444	57,143	—	57,143
セグメント利益	375	272	647	—	647

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

4. 補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	40,806	△5.7
コンピュータシステム関連事業	6,123	24.0
合計	46,930	△2.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	47,706	△1.7	13,514	3.8
コンピュータシステム関連事業	9,136	24.1	7,672	21.9
合計	56,843	1.7	21,187	9.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	48,698	3.7
コンピュータシステム関連事業	8,444	21.1
合計	57,143	5.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。